

業務目標及所得款項用途聲明

業務目標及策略

有關本集團的業務目標及策略，請參閱本文件「業務—業務策略」一節。

執行計劃

為按上文所述根據本集團的業務目標及策略，執行促進本集團離散式功率半導體的產銷的業務策略，下文所載為本集團自最後實際可行日期直至2018年12月31日各六個月期間的執行計劃。務請留意，執行計劃乃按下文「業務目標及所得款項用途聲明—基準及假設」一節各段所述的基準及假設制訂。該等基準及假設受限於多項不確定性及不可預測因素，特別是本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

最後實際可行日期至2016年12月31日

業務策略	所得款項用途	執行計劃
提高本集團離散式功率半導體的產能	[編纂]	● 藉增購機器，包括但不限於1台固晶機、3台線焊機、2台封膠／修邊機以及2台晶圓測試機，以擴充及發展其現有封裝設施的整體產能
	[編纂]	● 藉增購機器，包括但不限於1台封膠／修邊機及1台產品測試機，藉此發展DFN(5毫米×6毫米)封裝類型(QFN類封裝類型)離散式功率半導體的一條全新封裝生產線
	[編纂]	● 增購蕭基二極管測試專用機器，包括但不限於2台產品測試機
	[編纂]	● 增購MOSFET測試專用機器，包括但不限於1台產品測試機
持續研發工作	零	● 持續改良其蕭基二極管及MOSFET的產品性能
		● 通過開發更多不同規格的MOSFET產品型號，藉此擴大MOSFET的產品組合
		● 為所發現的任何新半導體技術及製造方法申請專利

業務目標及所得款項用途聲明

業務策略	所得款項用途	執行計劃
擴展分銷網絡	零	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續與其現有分銷商合作以物色全新客戶 ● 物色全新分銷商以發展全新客戶及全新市場，重心為太陽能板及工業電源供應器領域

截至2017年6月30日止六個月

業務策略	所得款項用途	執行計劃
提高本集團離散式功率半導體的產能	[編纂]	● 作為截至2016年12月31日止上一期間增購的機器的分期付款，以擴充及發展現有封裝設施整體產能
	[編纂]	● 作為截至2016年12月31日止上一期間增購的機器的分期付款，藉此發展DFN封裝類型(QFN類封裝類型)離散式功率半導體的一條全新封裝生產線
	[編纂]	● 作為截至2016年12月31日止上一期間增購MOSFET測試專用機器的分期付款
持續研發工作	零	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續改良其蕭基二極管及MOSFET的產品性能 ● 通過開發更多不同規格的MOSFET產品型號，藉此擴大MOSFET的產品組合 ● 為所發現的任何新半導體技術及製造方法申請專利
擴展分銷網絡	零	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續與其現有分銷商合作以物色全新客戶 ● 持續物色全新分銷商以發展全新客戶及全新市場，重心為汽車領域

業務目標及所得款項用途聲明

截至2017年12月31日止六個月

業務策略	所得款項用途	執行計劃
提高本集團離散式功率半導體的產能	[編纂]	<ul style="list-style-type: none">● 藉增購機器，包括但不限於1台固晶機、3台線焊機、2台封膠／修邊機及2台晶圓測試機，以擴充及發展其現有封裝設施的整體產能
持續研發工作	[編纂]	<ul style="list-style-type: none">● 增購蕭基二極管測試專用機器，包括但不限於2台產品測試機
	零	<ul style="list-style-type: none">● 持續改良其蕭基二極管及MOSFET的產品性能● 通過開發更多不同規格之MOSFET產品型號，藉此擴大MOSFET的產品組合● 為所發現的任何新半導體技術及製造方法申請專利
擴展分銷網絡	零	<ul style="list-style-type: none">● 持續與其現有分銷商合作以物色全新客戶● 持續物色全新分銷商以發展全新客戶及全新市場

業務目標及所得款項用途聲明

截至2018年6月30日止六個月

業務策略	所得款項用途	執行計劃
提高本集團離散式功率半導體的產能	[編纂]	● 藉增購機器，包括但不限於1台晶粒切割機、4台固晶機、4台線焊機、2台封膠／修邊機以及2台晶圓測試機，以擴充及發展其現有封裝設施的整體產能
	[編纂]	● 藉增購機器，包括但不限於1台封膠／修邊機及1台產品測試機，藉此發展DFN(3毫米x3毫米)封裝類型(QFN類封裝類型)離散式功率半導體的一條全新封裝生產線
	[編纂]	● 增購蕭基二極管測試專用機器，包括但不限於2台產品測試機
	[編纂]	● 增購MOSFET測試專用機器，包括但不限於1台產品測試機
持續研發工作	零	● 持續改良其蕭基二極管及MOSFET的產品性能
		● 通過開發更多不同規格的MOSFET產品型號，藉此擴大MOSFET的產品組合
		● 為所發現的任何新半導體技術及製造方法申請專利
擴展分銷網絡	零	● 持續與其現有分銷商合作以物色全新客戶
		● 持續物色全新分銷商以發展全新客戶及全新市場

業務目標及所得款項用途聲明

截至2018年12月31日止六個月

業務策略	所得款項用途	執行計劃
提高本集團離散式功率半導體的產能	零	<ul style="list-style-type: none"> ● 如有需要，檢討其蕭基二極管及MOSFET產能
持續研發工作	零	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續改良其蕭基二極管及MOSFET的產品性能 ● 通過開發更多不同規格的MOSFET產品型號，藉此擴大MOSFET的產品組合 ● 為所發現的任何新半導體技術及製造方法申請專利
擴展分銷網絡	零	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續與其現有分銷商合作以物色全新客戶 ● 持續物色全新分銷商以發展全新客戶及全新市場

預期產能變動

下表所載為前述購置機器後的預期產能變動資料：

	購置機器後 截至2015年 12月31日的 年度產能 上限(附註)	購置機器後 截至2016年 12月31日的 年度產能 上限(附註)	2015年至 2016年間的 年度產能 上限增幅	購置機器後 截至2017年 12月31日的 年度產能 上限(附註)	2016年至 2017年間的 年度產能 上限增幅	購置機器後 截至2018年 12月31日的 年度產能 上限(附註)	2017年至 2018年間的 年度產能 上限增幅
	件	件	%	件	%	件	%
晶圓測試及分類	207,240,000	275,240,000	32.8	343,240,000	24.7	411,240,000	19.8
封裝：							
(晶粒切割)	238,326,000	238,326,000	—	238,326,000	—	317,768,000	33.3
(固晶)	145,402,400	159,902,400	10.0	174,402,400	9.1	232,402,400	33.3
(線焊)	132,877,800	152,377,800	14.7	171,877,800	12.8	197,877,800	15.1
產品測試：							
1. TO220/ITO220	105,050,000	173,050,000	64.7	207,050,000	19.6	241,050,000	16.4
2. TO247	17,270,000	17,270,000	—	34,540,000	100.0	51,810,000	50.0

業務目標及所得款項用途聲明

附註：年產能上限按(i)各設備的設計日產能；及(ii)各年度為314個操作日計算。

基準及假設

編製直至2018年12月31日執行計劃時，董事已採納以下主要假設。

- (a) 本集團將具備充裕財務資源，足以應付本集團日後規劃相關期間內的已規劃資本開支以及業務發展所需；
- (b) 本文件所述本集團各項日後規劃的資金需求將不會有別於董事所估計金額；
- (c) 香港、台灣、中國以及本集團任何成員公司目前經營或將會經營業務以及目前提供或將會提供產品的任何其他地點的現有政治、法律、財政或經濟狀況概無任何重大變動；
- (d) 本集團將不會受本文件「風險因素」一節所載的任何風險因素重大影響；
- (e) 香港、台灣、中國或本集團任何成員公司目前經營或將會經營或註冊成立所在的任何其他地點的基本因素(例如通脹及利率)或稅率將概無任何重大變動；
- (f) [編纂]將根據本文件「[編纂]架構及條件」一節及按其所述完成；
- (g) 本集團將可挽留其客戶及供應商；
- (h) 本集團將可留用管理層以及主要營運部門的主要員工；及
- (i) 本集團將可按與往績記錄期間本集團營運方式大致相同的方式持續經營，而本集團將可進行發展計劃，而不會以任何方式備受干擾，以致對其營運或業務目標造成不利影響。

[編纂]理由及所得款項用途

[編纂]理由

為執行本集團的業務策略，本集團將收取的[編纂]所得款項淨額總額約[編纂]港元中，約[編纂]港元或[編纂]的所得款項淨額將需於2016年12月31日前動用，約[編纂]港元或[編纂]的所得款項淨額將需於2017年12月31日前動用，餘額約[編纂]港元或[編纂]的所得款項淨額將需於2018年12月31日前動用，進一步詳情載於本節。2016年3月31日，本集團的流動資產淨額僅約0.3百萬美元，於2016年7月31日的流動負債淨額則約為4.3百萬美元，而本集團錄得債務淨額(即銀行借款減現金及銀行結餘後淨額)約2百萬美元。另一方面，2016年3月31日，本集團資本負債比率約為4.58倍，分別較2014年及

業務目標及所得款項用途聲明

2015年12月31日約2.43倍及2.53倍有所增加。通過上市，本集團將可在股票市場集資，供執行其業務策略之用，而本集團流動資金就流動資產淨值及負債淨額狀況而言不會過度受壓。

董事亦認為，上市可讓本集團建立較廣潤的股東基礎，並提高其品牌認知度及知名度。本集團客戶以分銷商為主，彼等繼而出售本集團產品予本集團產品直接用家（即主要為電源供應器的製造商），其後將由製造商（作為最終用家）在彼等營銷全球的品牌電子產品使用。因此，上市將增進其於其他品牌電子產品製造商之間的品牌認知度及知名度，並有機會掌握使本集團產品符合資格而成為最終用家獲認可供應商的其他機遇，有關產品一般須由分銷商為該等最終用家向認可供應商採購。

此外，上市提供讓本集團開通資本市場的機會，以進行企業融資活動，協助日後業務發展。董事亦相信，本集團作為上市公司，可按較優惠條款自財務機構取得債務融資。

所得款項用途分析

本集團將收取的[編纂]所得款項淨額，經扣除相關開支後，估計將約為[編纂]港元。董事目前有意應用本集團將收取的所得款項淨額，藉購置相關設備提高本集團離散式功率半導體的產能。

根據因應最後實際可行日期直至2018年12月31日的本集團產能擴張資本開支的本集團執行計劃的所得款項用途。如本文件「業務目標及所得款項用途聲明—執行計劃—產能變動」一節所示，就封裝流程（即製造流程的主要步驟之一）而言，建基於根據本集團執行計劃的所得款項用途，(i)固晶的產能上限預期將於截至2018年12月31日止三個年度分別按年增加約10%、9.1%及33.3%；(ii)線焊的產能上限預期將於截至2018年12月31日止三個年度分別按年增加約14.7%、12.8%及15.1%；及(iii)預期截至2018年12月31日止年度晶粒切割的產能上限將較截至2015年12月31日止年度至增加約33.3%。

整體而言，由於封裝流程必須涵蓋上述三大步驟，因此，本集團的離散式功率半導體產能上限將屬封裝流程三大步驟中最低產能的一項，即線焊。值得注意的是，晶粒切割、固晶及線焊三大步驟中的每台機器有其各自的設計產能。如上文所述，截至2018年12月31日止三個年度，線焊的產能上限預期將分別按年增加約14.7%、12.8%及15.1%至約152,377,800件、171,877,800件及197,877,800件，亦即本集團同期的離散式功率半導體

業務目標及所得款項用途聲明

產能上限預期增長率。就晶粒切割而言，由於屬封裝流程三大步驟中的第一步，晶粒切割工序備受任何干擾，可能導致生產全流程備受干擾。因此，通過購置一台晶粒切割機以確保整體生產流程順暢，晶粒切割的產能上限預期將自現有的238,326,000件增加約33.3%至截至2018年12月31日止年度的317,768,000件。

本集團的成立可追溯至2006年，本集團的首件離散式功率半導體產品金氧半肅基整流器於2009年首度投產。如本文件「業務—市場及競爭」一節所述，2015年，全球半導體市場的收入約達335.5十億美元，當中，中國半導體市場收入約達95.2十億美元，按收入計，相當於全球半導體市場的28.4%。本集團收入約18.1百萬美元，僅相當於全球半導體市場收入約0.005%，以及中國半導體市場收入約0.02%，顯示本集團有機會涉足的龐大市場價值。

根據Prismark，自市場角度而言，預測肅基整流器將於2016年至2020年間按複合年增長率5.5%增至33十億件，而預測MOSFET將於2016年至2020年間按複合年增長率約5%增長。儘管肅基二極管市場及MOSFET市場增長較穩定，本集團在業務策略支持下，以在該等市場分佔較高市場份額為發展重心，方法為通過(i)開拓其離散式功率半導體現有應用範圍的市場領域，具體而言，以汽車領域及太陽能電池領域為重心；及(ii)擴大旗下有售的離散式功率半導體封裝類型產品至第四代封裝DFN封裝類型（一種QFN類封裝類型）。

為進一步開拓對本集團而言屬全新領域的汽車領域及太陽能電池領域，本集團將物色新分銷商發展新客戶及新市場，重心為以太陽能板及工業電源供應領域及汽車領域。2015年及2016年，本集團分別就汽車領域及太陽能電池領域委聘兩名分銷商，向（其中包括）汽車領域及／或太陽能電池領域分銷。於最後實際可行日期，本集團就汽車領域及太陽能電池領域各開發2種型號的肅基二極管以作相關用途。2015年底，節能元件（廣東）取得汽車製造商一般要求汽車相關產品供應商具備的TS16949:2009（汽車供應鏈專用國際認可質量管理體系認證）。董事相信，節能元件（廣東）取得TS16949:2009，可進一步協助本集團開拓汽車領域。董事亦告知，本集團目前有售的TO-220及TO-247封裝類型亦為汽車應用範圍使用的封裝類型，因此，董事認為，憑藉本集團於TO-220及TO-247封裝類型的經驗及專長，本集團已準備就緒，可開拓汽車領域，並使用其產能應對有關生產需求。

業務目標及所得款項用途聲明

為擴展旗下有售的離散式功率半導體封裝類型產品至第四代封裝DFN封裝類型（一種QFN類封裝類型），部分所得款項淨額將用於添置以DFN封裝類型封裝離散式功率半導體的新生產線。根據Prismark，預測QFN、DFN、SC-70等封裝類型於2016年至2020年間將按複合年增長率8.8%增長。如本文件「行業概覽—半導體市場需求及增長前景—離散式半導體封裝」一節所討論，根據Prismark，大部分便攜式消費品已在使用第四代封裝，並藉助呎吋小而性能佳的推動因素而取得最快速增長。於最後實際可行日期，本集團有14名分銷商向（其中包括）流動電話領域分銷。此外，於最後實際可行日期，本集團已開發11種MOSFET型號，供流動電話應用範圍使用。董事認為，旗下有售產品擴展至第四代封裝，讓本集團可藉營銷該等封裝的產品掌握流動電話市場的增長潛力。此外，就離散式功率半導體購置相關生產線並進行DFN封裝種類內部封裝，允許本集團通過其專責質控小組改善質控。通過內部進行封裝，交付採購訂單所需時間一般短於外包封裝，因此，本集團將可更快速應付客戶需求。董事相信，對其以該新封裝類型封裝的離散式功率半導體而言，產品質量及交貨時間短是建立客戶基礎關鍵。

除上文討論的兩項日後增長推動因素帶動產能增長需要超越蕭基二極管及MOSFET市場整體增長外，如「業務—競爭優勢」一節所披露者，董事相信，通過使用其本身的專利元件結構設計，本集團已在本集團客戶及產品用家間建立產品優質可靠美譽。據董事告知，若干離散式功率半導體直接用家／最終用家僅選擇向符合若干生產規模下限的供應商採購，因此，擴大生產規模可開拓本集團有機會涉足的該等客戶。董事相信，(i) 因性能、質量及可靠性，加上上市地位帶來的品牌認知度，本集團產品的品牌認受性日漸提高；及(ii) 本集團生產規模日漸擴大，尤其是藉應用[編纂]所得款項支持下，本集團的蕭基產品得以取得更高產品滲透率，並使其離散式功率半導體的市場需求更形殷切。事實上，本集團自銷售離散式功率半導體所產生的收入於截至2015年12月31日止年度按年增加約10.5%，並於截至2016年3月31日止三個月按期增加約61.6%。

此外，儘管本集團的MOSFET現正處於建立產品組合階段，而本集團將繼續其研發工作，以（其中包括）開發規格各異的更多MOSFET產品型號，藉此擴大MOSFET的產品組合。本集團計劃於2016年底前把MOSFET現有產品組合自69個型號增至90個型號，並於2017年另增100個型號。董事認為，MOSFET產品組合精良，可帶動其MOSFET產品市場需求攀升。

業務目標及所得款項用途聲明

根據Prismark，自市場角度而言，蕭基為本的整流器在2015年全球售出的63十億件整流器中分佔約40%或25.2十億件。預測蕭基整流器將於2016年至2020年間按複合年增長率5.5%增長至達33十億件，並預期將維持其現有市場份額。另一方面，MOSFET在2015年售出的4.8十億件功率晶體管中分佔約75%或36十億件，並預測將於2016年至2020年間按複合年增長率約5%增長。

根據Prismark，就封裝而言，第一代封裝的出貨量估計將於2020年前按複合年增長率約1.6%增至約49十億件，由於成本低而熱電性卓越，因此，第一代封裝將繼續使用。具體而言，2016年至2020年間，本集團的主要封裝類型TO-220封裝類型及該類的出貨量估計將按複合年增長率約4%攀升，因成本低企及熱電性卓越而亦非常適合一系列包括蕭基二極管及MOSFET在內的離散式功率半導體使用，故表現較同代／其他代的若干封裝類型優秀。本集團將不時檢討封裝類型的市場需求，並以其他恰當封裝類型出售其離散式功率半導體。

就晶圓測試及分類而言，按根據本集團執行計劃的所得款項用途，產能上限預期將於截至2018年12月31日止三年按年增加約32.8%、24.7%及19.8%。取決於產品規格，一件離散式功率半導體可能包括一或兩件晶粒。因此，因應離散式功率半導體整體產能相應增幅，晶圓測試及分類機器所需的產能增幅將較高。

就產品測試而言，按根據本集團執行計劃的所得款項用途，(i) TO-220/ITO-220封裝類型的產能上限預期將於截至2018年12月31日止三年按年增加約64.7%、19.6%及16.4%；及(ii) TO-247封裝類型的產能上限預期將於截至2018年12月31日止兩年按年增加約100%及50%。由於每件半導體成品均會根據軟件程式輔助測試設備進行的自動化流程進行測試，故按件數計，產品測試機器的產能增幅符合離散式功率半導體整體產能相應增幅。

本集團產能擴充的規劃資本開支旨在順應其離散式功率半導體日益殷切的需求，有關需求源自(i)本集團致力開拓其離散式功率半導體現有應用範圍的市場領域，特別是以汽車領域及太陽能電池領域，並擴展其有售的離散式功率半導體封裝類型產品，開拓至藉助呎吋小而性能佳的推動因素而取得最快速增長的第四代封裝；(ii)本集團蕭基產品在市場產品滲透率日高的預期；及(iii)MOSFET產品組合擴大，可帶動本集團的離散式

業務目標及所得款項用途聲明

功率半導體市場需求日益殷切。規劃資本開支與本集團自銷售離散式功率半導體所得收入的增長一致，即截至2015年12月31日止年度按年增長約10.5%，截至2016年3月31日止三個月按期增長約61.6%。董事認為，產能增長高於Prismark所預測的行業趨勢，故該等開支理據充分。

就研發而言，本集團的研發流程一般涉及元件結構的設計、模擬及測試，包括但不限於通過電腦軟件及原型測試設備進行設計模擬。就分銷網絡而言，本集團藉擴展分銷網絡營銷產品，期間本集團將委聘更多分銷商推廣及出售本集團產品。有關本集團研發及營銷的進一步詳情，請參閱本文件「業務—研發」以及「業務—銷售及營銷」兩節。董事認為，就(i)持續本集團研發工作；及(ii)擴展本集團分銷網絡的業務策略而言，本集團內部資源將足以使用內部資源執行該等策略，而執行該等策略將毋須動用[編纂]所得款項。

概要而言，最後實際可行日期直至2018年12月31日，本集團業務目標以及策略的執行將由本集團將收取的[編纂]所得款項淨額提供資金如下：

最後實際 可行日期至	截至以下日期止六個月					總計	佔總所得 款項淨額 百分比
	2016年	2017年	2017年	2018年	2018年		
	12月31日	6月30日	12月31日	6月30日	12月31日		
	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	%
提高本集團離散式 功率半導體的產銷， 通過以下各項：							
為現有封裝設施 購置機器	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
為DFN封裝類型 開發全新生產線	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
為測試蕭基二極管 購置機器	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
為測試MOSFET 購置機器	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
本集團一般營運資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

業務目標及所得款項用途聲明

本集團有意應用本集團將收取的[編纂]所得款項淨額增購機器，包括但不限於6台晶圓測試機、1台晶粒切割機、6台固晶機、10台線焊機、8套封膠／修邊機及8台產品測試機。

董事認為本集團將收取的[編纂]所得款項淨額及本集團內部資源及可供本集團動用現有銀行融資將足以撥資本集團直至截至2018年12月31日止年度的業務計劃。

倘若本集團將收取的[編纂]所得款項淨額並非須即時用於上述用途，董事目前有意將該等所得款項淨額存入於認可財務機構持有的短期計息存款戶口。

[編纂]股[編纂]中，售股股東將按配售價提呈發售合共[編纂]股待售股份。售股股東自銷售[編纂]收取的所得款項淨額將約達[編纂]港元。本公司將不會自[編纂]項下由售股股東出售待售股份收取任何所得款項。